

证券代码：001389

证券简称：广合科技

广州广合科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-10

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ ） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名（排名不分先后）	申万宏源、玄甲资本
时间	2024年5月31日 10:00-11:00
地点	广州广合科技股份有限公司会议室
公司接待人员	副总经理、董事会秘书：曾杨清 证券事务代表：陈炜亮、黄淑芳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、今年毛利率会受原材料涨价的影响吗？</p> <p>一季度原材料价格比较稳定，4、5月份受大宗商品价格上升影响，部分材料价格有所上升，但目前对公司影响较小，公司密切关注大宗商品价格的未来走势，并通过内部降本增效、优化产品结构等手段来降低原材料成本上升对经营的影响。</p> <p>二、服务器 PCB 未来竞争的格局？</p>

关注和计划参与服务器应用市场竞争的同行越来越多，公司未来面临的竞争压力肯定会加大，但广合科技长期聚焦数据中心业务，对服务器产品的迭代，以及对服务器产品研究的深度和广度具备优势，多年来在服务器客户中也有一定的沉淀和积累，我们会积极应对市场竞争。

三、泰国工厂产能规划？工厂定位？预计泰国工厂什么时候可以满产？

泰国工厂预计今年年底建成投产，预计满产年销售约 20 亿元，主要产品定位新一代服务器及交换机产品，主要面对海外市场。泰国工厂 2025 年会有一个产能爬坡的过程，影响产能提升的因素比较多，公司也在为泰国工厂的投产积极准备，力争把产能爬坡期缩短。

四、从 PCIE4.0 到 PCIE5.0 的工艺提升差异体现在哪些方面？价值量提升的原因？

为了满足信号需求传输速率的提升要求，PCB 主材从 M5 升级到 M6，两代服务器 PCB 的工艺标准也有本质的提升，比如：产品层数由 12-18L 上升至 14-20L，BGA Pitch 由 1mm 减少至 0.94mm，板厚大幅增加，厚径比大幅提升，背钻及真空树脂塞孔等工艺大范围使用等等。PCIE4.0 到 PCIE5.0 产品，无论从材料成本还是加工工艺难度都有大幅提升，相应的产品单价也有大幅提升。

五、原材料价格上涨会传导给下游客户吗？

	<p>公司主要通过内部降本增效、优化产品结构来降低原材料成本上升对经营造成的影响。同时公司也会密切上下游供应商、客户的沟通与协作，以降低原材料价格波动对经营的影响。</p> <p>六、服务器市场增长平稳，公司未来增长的驱动力是什么？</p> <p>未来服务器业务依然是公司核心业务，目前公司在服务器市场的份额还有很大提升空间，除了进一步提升现有客户份额，我们将积极拓展目前尚未覆盖的客户；除此之外，公司围绕自身业务规划，后期也将加大通信及智能终端业务的拓展力度。</p> <p>注：调研过程中公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024年5月31日</p>